

Verbund-Entlötspitze SOP 10L - Hakko T16-1007

Artikel-Nr. HK-T16-1007

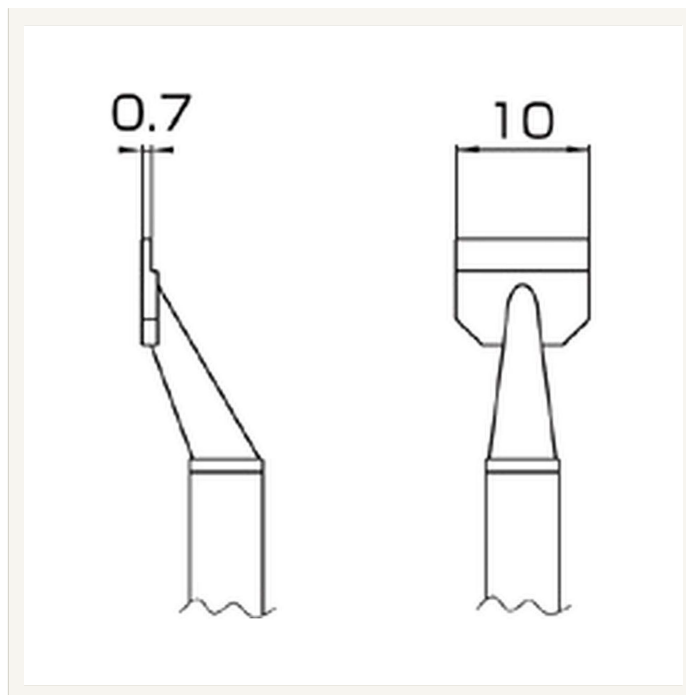
Hersteller Hakko

EAN 4962615028113

Verbund-Entlötspitze im Format SOP 10L für den Einsatz mit der Hakko FM 2022 Parallel-Entlötpinzette. Die Packung enthält 2 Ersatzspitzen für das effiziente Entfernen von SMD-Bauteilen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko T16-1007 ist eine Verbund-Entlötspitze, die speziell für das Parallel-Entlötpinzetten-System FM 2022 entwickelt wurde. Mit ihrem Format SOP 10L ermöglichen diese Spitzen das präzise und effiziente Entfernen oberflächenmontierter Bauteile von Leiterplatten, ohne benachbarte Komponenten oder Leiterbahnen zu beschädigen.

WESENTLICHE MERKMALE

- Format SOP 10L, optimiert für Bauteile im Small-Outline-Package
- Verbundkonstruktion für höhere Haltbarkeit und thermische Leistung
- Kompatibel mit der Parallel-Entlötpinzette FM 2022
- Packung mit 2 Ersatzspitzen
- Präzisionsgefertigt für SMD-Entlötanwendungen
- Zuverlässige Lötbenetzung und Wärmeübertragung

ANWENDUNGEN

Ideal für Nacharbeits- und Reparaturarbeiten an Bauteilen im Small-Outline-Package (SOP). Geeignet für die Elektronikfertigung, die Leiterplattenbestückung und Reparaturen auf Bauteilebene, bei denen präzises Entlöten erforderlich ist.

LIEFERUMFANG

- 2 × Verbund-Entlötpitzen Format SOP 10L